## (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-310422 (P2001-310422A)

(43)公開日 平成13年11月6日(2001.11.6)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ	テーマコート*(参考)					
B 3 2 B	27/00			В32	B 27/00		L	4F100		
	27/30				27/30		В	4J002		
C08L	25/08			C 0 8	3 L 25/08		•			
// (C08L	25/08			(C 0 8	L 25/08					
	23: 02				23: 02		-			
		•	45 株本学	<b>卡姆</b> 4	競売頂の数11	Ωī	(今 11 百)	具数百に姓く		

(21) 出願番号 特願2000-131167(P2000-131167) (71) 出願人 000183657

(22) 出願日 平成12年4月28日(2000.4.28) 出光石油化学株式会社 東京都墨田区横網一丁目6番1号

(72) 発明者 内田 隆明

千葉県市原市姉崎海岸1番地1 (74)代理人 100081765

弁理士 東平 正道

最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 離型フィルム

# (57) 【要約】

【課題】 離型性が優れると共に引張伸びなどの力学物性も同時に優れ、しかも耐熱性や環境適性に優れる、プリント基板製造などに用いられる離型フィルムを提供する。

【解決手段】 1層又は2 層以上の層からなる厚みが2  $5 \sim 300 \mu$  mの離型フィルムであって、少なくとも1 つの表面層が、シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体を主成分とし合有し、しかも該表面層の光沢度が100%未満である離型フィルムである。

BEST AVAILABLE COPY

- 1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】1層又は2層以上の層からなる厚みが25  $\sim 300 \mu$ mの離型フィルムであって、少なくとも1つの表面層が、シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体を主成分として含有し、しかも該表面層の光沢度が100%未満である離型フィルム。

【請求項2】 該表面層が、シンジオタクチック構造を 有するスチレン系重合体を85~99.9質量%含有す る請求項1に記載の離型フィルム。

【請求項3】 該表面層が、シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体以外の熱可塑性樹脂及び熱可塑性エラストマーから選ばれた1種又は2種以上を0.1~15質量%、並びに相溶化剤0~10質量%含む請求項1又は2に記載の離型フィルム。

【請求項4】 該表面層の組成が、シンジオタクチック 構造を有するスチレン系重合体85~98質量%、ポリ オレフィン系重合体1~15質量%、スチレン系ゴム1 ~15質量%及び相溶化剤0~10質量%とを含有する 請求項2又は3に記載の離型フィルム。

【請求項5】 A層及びC層を表面層とし、両表面層の 20 間に1又は2層以上のB層が存在する厚みが $25\sim30$  0  $\mu$ mの離型フィルムであって、A層、各B層、及びC 層が下記の組成で構成される離型フィルム。

A層:シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体を主成分として含有し、しかも該層の光沢度が100 %未満である層

各B層:スチレン系重合体30~90質量%、スチレン 系重合体以外の熱可塑性樹脂及び熱可塑性エラストマー から選ばれた1種又は2種以上を10~70質量%、並 びに相溶化剤0~30質量%を含有する層

C層:シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体70~100質量%、シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体以外の熱可塑性樹脂及び熱可塑性エラストマーから選ばれた1種又は2種以上を0~30質量%、並びに相溶化剤0~10質量%を含む層

【請求項6】 A層が、シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体を85~99.9質量%含有する請求項5に記載の離型フィルム。

【請求項7】 C層の光沢度が100%未満である請求項5又は6に記載の離型フィルム。

【請求項8】 B層の少なくとも1層が、シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体30~70質量%、シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体以外のスチレン系重合体0~30質量%、ポリオレフィン10~50質量%、熱可塑性エラストマー0~30質量%及び相溶化剤0~30質量%を含有する請求項5~7のいずれかに記載の離型フィルム。

【請求項9】 B層が、1層からなる請求項5~8のいずれかに記載の離型フィルム。

【請求項10】離型フィルム中に存在するシンジオタク 50 った。

2

チック構造を有するスチレン系重合体の結晶化度が30 %以上である請求項1~9のいずれかに記載の離型フィルム。

【請求項11】各層の厚さの比、A層:全B層:C層が 1~49:50~98:1~49である請求項5~10 のいずれかに記載の離型フィルム。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、離型フィルムに関し、詳しくは、シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体(以下、「SPS」と略称することがある。)を含む層からなる離型フィルムであって、離型性及び力学物性に優れるためプリント基板製造などに用いられる離型フィルムとして有用なフィルムに関する。

[0002]

【従来の技術】離型フィルムは、いわゆる「剥がれる機能」を有するフィルムの総称であり、剥離フィルム、工程フィルム、包装フィルム等がある。ここで言う工程フィルムとは、プリント基板やICチップ(ウェハーモールド)、セラミックス電子部品、熱硬化性樹脂製品、化粧板等を製造する時、金属板同士や樹脂同士が接着してしまわないように、成形工程時に該金属板同士の間や樹脂同士の間に挟み込まれるフィルムをいう。このような工程フィルムには、離型性が優れると共に、工程中に受ける力に耐えるため靭性などの機械的強度が高いことが要求される。

【0003】従来、これらの工程フィルムとしては、テ フロン(登録商標)(PTFE)等のフッ素樹脂系フィ ルムやポリ(4-メチルペンテン-1)フィルム、さら には二軸延伸ポリエチレンテレフタレート(PET)表 層にシリコン系材料を塗布したフィルム等が用いられて きた。また、最近SPSを用いる離型フィルムが提案さ れている(特開平11-349703号公報、特開平2 000-38461号公報)。しかしながら、フッ素樹 脂系フィルムは焼却しにくいため、使用済のものは産業 廃棄物となり、仮に焼却した場合はフッ素含有ダイオキ シンの発生が懸念される。またポリ(4-メチルペンテ ン-1)フィルムは耐熱性が十分ではなく、プリント基 。 板製造時、ステンレス板との熱密着が生じてしまうとい う問題がある。また二軸延伸PETそのものだけではぬ れ指数が高いため、離型性が不十分であり、PET表層 にシリコン系材料を塗布したフィルムは、シリコンがプ リント基板やセラミックス電子部品、熱硬化性樹脂製 品、化粧板等に付着するという問題があった。一方、S PSを用いたフィルムは離型性には優れるものの、引張 伸びなどの力学物性が不十分であり、また、SPSと熱 可塑性樹脂とを併用したフィルムは、離型性と力学物性 の両者を同時に満足するものが得られず、いずれもプリ ント基板などの工程フィルムとしては不十分なものであ

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記観点からなされたものであり、離型性が優れると共に引張伸びなどの力学物性も同時に優れ、しかも耐熱性や環境適正に優れる、プリント基板製造などに用いられる離型フィルムを提供することを目的とする。

3

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、少なくとも1つの表面層がSPSを主成分として含有し、しかもその10フィルムの光沢度を一定値以下に制御した離型フィルムが、本発明の目的を効果的に達成できることを見出し、本発明を完成したものである。即ち、本発明の要旨は以下の通りである。

- $\langle 1 \rangle$  1層又は2層以上の層からなる厚みが25~30 0  $\mu$ mの離型フィルムであって、少なくとも1つの表面層が、シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体を主成分として含有し、しかも該表面層の光沢度が100%未満である離型フィルム。
- 〈2〉該表面層が、シンジオタクチック構造を有するス 20 チレン系重合体を85~99.9質量%含有する前記
- 〈1〉に記載の離型フィルム。
- 〈3〉該表面層が、シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体以外の熱可塑性樹脂及び熱可塑性エラストマーから選ばれた1種又は2種以上を0.1~15質量%、並びに相溶化剤0~10質量%含む前記〈1〉又は〈2〉に記載の離型フィルム。

【0006】〈4〉該表面層の組成が、シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体を85~98質量%、ポリオレフィン系重合体1~15質量%、スチレン 30系ゴム1~15質量%及び相溶化剤0~10質量%とを含有する前記〈2〉又は〈3〉に記載の離型フィルム。

〈5〉A層及びC層を表面層とし、両表面層の間に1又は2層以上のB層が存在する厚みが $25\sim300\mu$ mの離型フィルムであって、A層、各B層、及びC層が下記の組成で構成される離型フィルム。

A層:シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体を主成分として含有し、しかも該層の光沢度が100%未満である層。

各B層:スチレン系重合体30~90質量%、スチレン 40 系重合体以外の熱可塑性樹脂及び熱可塑性エラストマーから選ばれた1種又は2種以上を10~70質量%、並びに相溶化剤0~30質量%を含有する層。

C B: シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体 70~100 質量%、シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体以外の熱可塑性樹脂及び熱可塑性エラストマーから選ばれた1種又は2種以上を0~30質量%、並びに相溶化剤0~10質量%を含む層。

(6) A層が、シンジオタクチック構造を有するスチ レン系重合体を85~99.9質量%含有する前記 〈5〉に記載の離型フィルム。

- 〈7〉 C層の光沢度が100%未満である前記〈5〉又は〈6〉に記載の離型フィルム。
- 〈8〉 B層の少なくとも1層が、シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体30~70質量%、シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体以外のスチレン系重合体0~30質量%、ポリオレフィン10~50質量%、熱可塑性エラストマー0~30質量%及び相溶化剤0~30質量%を含有する前記〈5〉~〈7〉のいずれかに記載の離型フィルム。
- 〈9〉 B層が、1層からなる前記〈5〉~〈8〉のいずれかに記載の離型フィルム。
- $\langle 1 \ 0 \rangle$  離型フィルム中に存在するシンジオタクチック 構造を有するスチレン系重合体の結晶化度が  $3 \ 0 \%$ 以上 である前記  $\langle 5 \rangle \sim \langle 9 \rangle$  のいずれかに記載の離型フィ ルム。
- $\langle 1 1 \rangle$  各層の厚さの比、A層:全B層:C層が $1 \sim 4$  9:50 $\sim$ 98: $1 \sim 4$ 9である前記 $\langle 5 \rangle \sim \langle 1 0 \rangle$  のいずれかに記載の離型フィルム。

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て説明する。

1. 離型フィルムの物性、組成及び層構成本発明の離型フィルムは、1層又は2層以上の層からなる厚みが $30\sim300\mu$ mの離型フィルムであって、少なくとも1つの表面層が、SPSを主成分として含有し、しかも該表面層の光沢度が100%未満である離型フィルムである。

【0008】すなわち、本発明の離型フィルムは、その少なくとも1つの表面層の光沢度が100%未満であることを特徴とするものである。この表面層の光沢度は90%未満であることがより好ましく、80%未満であることが特に好ましい。この層の光沢度が100%以上では、充分な離型性が得られない。

【0009】ここでいう光沢度は、JIS K 7105 に準拠して、測定角度60°で測定すればよく、通常、 屈折率1.567のガラス表面の光沢度を100%と し、当該表面層の光沢度を表す。

【0010】上記表面層の光沢度を100%未満に制御する手段については、その層の組成を適宜選定することが必要である。また、フィルムの成形方法についても適切に選定することが有効な場合もある。

【0011】すなわち、本発明の離型フィルムの少なくとも1つの表面層は、SPSを85~99.9質量%含有することが好ましい。このSPSの含有量は90~98質量%がより好ましく、92~98質量%が特に好ましい。この、SPSの含有量が99.9質量%を超えると、通常の成形方法では光沢度が100%以上になり、簡易にそれを100%未満にすることは困難であって、

50 経済的ではない。一方、SPSの含有量が85質量%未

などがある。

5

満であっても、充分な離型性が得られないことがある。 また、上記の少なくとも1つの表面層は、SPSを85 ~99.9質量%含有するとともに、SPS以外の熱可 塑性樹脂及び熱可塑性エラストマーから選ばれた1種又 は2種以上を0.1~15質量%、好ましくは2~10 質量%、並びに相溶化剤0~10質量%含む層が好まし い。このような組成であれば、光沢度を100%未満に 保つとともに、フィルムの力学物性を高めることができ る。特に熱可塑性樹脂としてオレフィン系樹脂、中でも ポリエチレンやポリプロピレンを用いた場合は、力学物 10 性を高めるのみでなく、光沢度を下げる効果をも有す る。この効果は、熱可塑性エラストマー、中でもスチレ ン系ゴム状弾性体を併用すると一層顕著となる。また、 この少なくとも1つの表面層には、相溶化剤を含有させ てもよく、これによって力学物性をさらに高めることが でき、その効果は熱可塑性樹脂や熱可塑性エラストマー が存在する場合により大きくなる。

【0012】したがって、少なくとも1つの表面層としては、SPS85~98質量%、ポリオレフィン系重合体1~15質量%、スチレン系ゴム状弾性体1~15質 20量%及び相溶化剤0~10質量%とを含有する組成であるのが、好ましい態様の1つである。なお、本発明においては、本発明の目的を阻害しない限り各種添加剤を配合することができる。以下、本発明に用いるSPS、SPS以外の熱可塑性樹脂及び熱可塑性エラストマー、相溶化剤及び各種添加剤について説明する。

[0013](1-1) SPS

本発明に用いるSPSにおけるシンジオタクチック構造 とは、立体化学構造がシンジオタクチック構造、即ち炭 素-炭素結合から形成される主鎖に対して側鎖であるフ エニル基が交互に反対方向に位置する立体構造を有する ものであり、そのタクティシティーは同位体炭素による 核磁気共鳴法( $^{13}$ C-NMR)により定量される。 $^{13}$ C -NMR法により測定されるタクティシティーは、連続 する複数個の構成単位の存在割合、例えば2個の場合は ダイアッド、3個の場合はトリアッド、5個の場合はペ ンタッドによって示すことができるが、本発明に言うS PSとは、通常はラセミダイアッドで75%以上、好ま しくは85%以上、若しくはラセミペンタッドで30% 以上、好ましくは50%以上のシンジオタクティシティ ーを有するポリスチレン、ポリ(アルキルスチレン)、 ポリ(ハロゲン化スチレン)、ポリ(ハロゲン化アルキル スチレン)、ポリ(アルコキシスチレン)、ポリ(ビニ ル安息香酸エステル)、これらの水素化重合体およびこ れらの混合物、あるいはこれらを主成分とする共重合体 を指称する。なお、ここでポリ(アルキルスチレン)と しては、ポリ(メチルスチレン)、ポリ(エチルスチレ ン)、ポリ(イソピルスチレン)、ポリ(ターシャリー ブチルスチレン)、ポリ(フェニルスチレン)、ポリ (ビニルナフタレン)、ポリ(ビニルスチレン)などが 50 あり、ポリ (ハロゲン化スチレン) としては、ポリ (クロロスチレン)、ポリ (プロモスチレン)、ポリ (フルオロスチレン) などがある。また、ポリ (ハロゲン化アルキルスチレン) としては、ポリ (クロロメチルスチレン) など、またポリ (アルコキシスチレン) としては、ポリ (メトキシスチレン)、ポリ (エトキシスチレン)

【0014】なお、これらのうち特に好ましいスチレン 系重合体としては、ポリスチレン、ポリ (p-メチルス チレン)、ポリ(m-メチルスチレン)、ポリ(p-タ ーシャリーブチルスチレン)、ポリ(p-クロロスチレ ン)、ポリ(m-クロロスチレン)、ポリ(p-フルオ ロスチレン)、水素化ポリスチレン及びこれらの構造単 位を含む共重合体が挙げられる。このようなSPSは、 例えば不活性炭化水素溶媒中または溶媒の不存在下に、 チタン化合物及び水とトリアルキルアルミニウムの縮合 生成物を触媒として、スチレン系単量体(上記スチレン 系重合体に対応する単量体)を重合することにより製造 することができる(特開昭62-187708号公報)。 また、ポリ(ハロゲン化アルキルスチレン)については 特開平1-46912号公報、これらの水素化重合体は 特開平1-178505号公報記載の方法などにより得 ることができる。

【0015】更に、スチレン系共重合体におけるコモノマーとしては、上述の如きスチレン系重合体のモノマーのほか、エチレン、プロビレン、ブテン、ヘキセン、オクテン等のオレフィンモノマー、ブタジエン、イソプレン等のジエンモノマー、環状ジエンモノマーやメタクリル酸メチル、無水マレイン酸、アクリロニトリル等の極性ビニルモノマー等をあげることができる。

【0016】特に、スチレン繰返し単位が80~100 モル%, p-メチルスチレン繰返し単位が0~20モル%からなるスチレン系重合体が好ましく用いられる。また、このスチレン系重合体の分子量については特に制限はないが、質量平均分子量が50,000~500,000のものが好ましく、とりわけ150,000~300,000のものがさらに好ましい。ここで質量平均分子量が50,000未満であると、フィルムの力学物性が不充分になる場合がある。さらに、分子量分布についてはその広狭は制約がなく、様々なものを充当することが可能であるが、質量平均分子量(Mw)/数平均分子量(Mn)が1.0~3.0のものが好ましい。

【0017】(1-2)スチレン系重合体以外の熱可塑 性樹脂

本発明で用いるシンジオタクチックポリスチレン以外の 熱可塑性樹脂としては、直鎖状高密度ポリエチレン、直 鎖状低密度ポリエチレン、高圧法低密度ポリエチレン、 アイソタクチックポリプロピレン、シンジオタクチック ポリプロピレン、ブロックポリプロピレン、ランダムポ リプロピレン、ポリブテン、1,2-ポリブタジエン、

ポリ4-メチルペンテン、環状ポリオレフィン及びこれ らの共重合体に代表されるポリオレフィン系樹脂、アタ クチックポリスチレン、アイソタクチックポリスチレ ン、HIPS、ABS、AS、スチレンーメタクリル酸 共重合体、スチレンーメタクリル酸・アルキルエステル 共重合体、スチレンーメタクリル酸・グリシジルエステ ル共重合体、スチレンーアクリル酸共重合体、スチレン ーアクリル酸・アルキルエステル共重合体、スチレンー マレイン酸共重合体、スチレンーフマル酸共重合体に代 表されるポリスチレン系樹脂、ポリカーボネート、ポリ エチレンテレフタレート、ポリプチレンテレフタレート をはじめとするポリエステル系樹脂、ポリアミド6、ポ リアミド6,6をはじめとするポリアミド系樹脂、ポリ フェニレンエーテル、PPS等公知のものから任意に選 択して用いることができる。これら中でも、ポリオレフ ィン系樹脂、特にポリエチレンやポリプロピレンが好ま しい。なお、これらの熱可塑性樹脂は一種のみを単独 で、または、二種以上を組み合わせて用いることができ る。

【0018】(1-3) 熱可塑性エラストマー 本発明で用いる熱可塑性エラストマーの具体例として は、例えば、天然ゴム、ポリブタジエン、ポリイソプレ ン、ポリイソブチレン、ネオプレン(登録商標)、ポリ スルフィドゴム、チオコールゴム、アクリルゴム、ウレ タンゴム、シリコーンゴム、エピクロロヒドリンゴム、 及びスチレンープタジエンブロック共重合体(SB R)、水素添加スチレン-プタジエンブロック共重合体 (SEB)、スチレンープタジエンースチレンブロック 共重合体(SBS)、水素添加スチレンープタジエンー スチレンプロック共重合体(SEBS)、スチレンーイ ソプレンブロック共重合体(SIR)、水素添加スチレ ンーイソプレンブロック共重合体 (SEP)、スチレン ーイソプレンースチレンプロック共重合体(SIS)、 水素添加スチレンーイソプレンースチレンブロック共重 合体(SEPS)などのスチレン系ゴム、さらにはエチ レンプロピレンゴム(EPM)、エチレンプロピレンジ エンゴム(EPDM)、直鎖状低密度ポリエチレン系エ ラストマー等のオレフィン系ゴム、あるいはブタジエン ーアクリロニトリルースチレンーコアシェルゴム (AB S)、メチルメタクリレート-ブタジエン-スチレン-コアシェルゴム (MBS)、メチルメタクリレートープ チルアクリレートースチレン-コアシェルゴム (MA S)、オクチルアクリレート-ブタジエン-スチレン-コアシェルゴム (MABS)、アルキルアクリレートー プタジエンーアクリロニトリルースチレンーコアシェル ゴム(AABS)、ブタジエンースチレンーコアシェル ゴム(SBR)、メチルメタクリレートープチルアクリ レートーシロキサンをはじめとするシロキサン含有コア シェルゴム等のコアシェルタイプの粒子状弾性体、また はこれらを変性したゴム等が挙げられる。これらの中で 50 8

も、スチレン系ゴムが特に好ましい。【0019】(1-4) 相溶化剤

本発明で用いる相溶化剤とは、スチレン構造を含む共重 合体であって、分子中にスチレン構造を40モル%以 上、好ましくは50モル%以上含む重合体である。スチ レン構造が40モル%未満の重合体は、いわゆるゴム状 弾性体に該当し、SPSとSPS以外の熱可塑性樹脂や 熱可塑性エラストマーとの結びつきを高め、フィルムの 力学物性を一層向上する本発明の相溶化剤の機能を果た せない。このような相溶化剤の具体例としては、例えば スチレンーブタジエンブロック共重合体 (SBR)、水 素添加スチレンープタジエンプロック共重合体(SE B)、スチレンーブタジエンースチレンブロック共重合 体(SBS)、水素添加スチレン-ブタジエン-スチレ ンプロック共重合体(SEBS)、スチレンーイソプレ ンプロック共重合体(SIR)、水素添加スチレンーイ ソプレンプロック共重合体(SEP)、スチレンーイソ プレンースチレンプロック共重合体(SIS)、水素添 加スチレンーイソプレンースチレンブロック共重合体 (SEPS) などが挙げられる。これらはいずれもスチ レン構造を50モル%以上含む重合体である。

【0020】(1-5) 各種添加剤 ① アンチブロッキング剤(AB剤) アンチブロッキング剤としては、以下のような無機粒子 又は有機粒子が挙げられる。無機粒子としては、IA 族、IIA族、IVA族、VIA族、VII A族、VIII族、IB 族、IIB族、III B族、IVB族元素の酸化物、水酸化 物、硫化物、窒素化物、ハロゲン化物、炭酸塩、硫酸 塩、酢酸塩、燐酸塩、亜燐酸塩、有機カルボン酸塩、珪 酸塩、チタン酸塩、硼酸塩及びそれらの含水化合物、そ れらを中心とする複合化合物及び天然鉱物粒子が挙げら

【0021】具体的には、弗化リチウム、ホウ砂(硼酸 ナトリウム含水塩)等のIA族元素化合物、炭酸マグネ シウム、燐酸マグネシウム、酸化マグネシウム(マグネ シア)、塩化マグネシウム、酢酸マグネシウム、弗化マ グネシウム、チタン酸マグネシウム、珪酸マグネシウ ム、珪酸マグネシウム含水塩(タルク)、炭酸カルシウ ム、燐酸カルシウム、亜燐酸カルシウム、硫酸カルシウ ム(石膏)、酢酸カルシウム、テレフタル酸カルシウ ム、水酸化カルシウム、珪酸カルシウム、弗化カルシウ ム、チタン酸カルシウム、チタン酸ストロンチウム、炭 酸バリウム、燐酸バリウム、硫酸バリウム、亜硫酸バリ ウム等のIIA族元素化合物、二酸化チタン(チタニ ア)、一酸化チタン、窒化チタン、二酸化ジルコニウム (ジルコニア)、一酸化ジルコニウム等のIVA 族元素化 合物、二酸化モリブデン、三酸化モリブデン、硫化モリ プデン等のVIA族元素化合物、塩化マンガン、酢酸マン ガン等のVII A族元素化合物、塩化コバルト、酢酸コバ ルト等のVIII族元素化合物、沃化第一銅等のIB族元素

化合物、酸化亜鉛、酢酸亜鉛等のIIB族元素化合物、酸化アルミニウム(アルミナ)、水酸化アルミニウム、弗化アルミニム、アルミナシリケート(珪酸アルミナ、カオリン、カオリナイト)等のIIIB族元素化合物、酸化珪素(シリカ、シリカゲル)、石墨、カーボン、グラファイト、ガラス等のIVB族元素化合物、カーナル石、カイナイト、雲母(マイカ、キンウンモ)、バイロース鉱等の天然鉱物の粒子が挙げられる。

【0022】有機粒子としては、テフロン、メラミン系 樹脂、スチレン・ジビニルベンゼン共重合体、アクリル 10 系レジンシリコーン及びおよびそれらの架橋体が挙げら れる。

【0023】ここで、用いる無機粒子の平均粒径は $0.1\sim10\mu$ m、添加量は $0.01\sim15$ 重量%が好ましい。なおこれらの無機充填材は一種のみを単独または二種以上を組み合わせて用いることができる。

#### 【0024】② 酸化防止剤

酸化防止剤としてはリン系、フェノール系、イオウ系等公知のものから任意に選択して用いることができる。なお、これらの酸化防止剤は一種のみを単独で、または、二種以上を組み合わせて用いることができる。さらには、好適に、2-[1-ヒドロキシー3,5-ジーt-ペンチルフェニル)エチル〕-4,6-ジーt-ペンチルフェニルアクリレートも挙げられる。

#### 【0025】③ 核剤

核剤としてはアルミニウムジ(p-t-ブチルベンゾエート)をはじめとするカルボン酸の金属塩、メチレンピス(2,4-ジーt-ブチルフェノール)アシッドホスフェートナトリウムをはじめとするリン酸の金属塩、タルク、フタロシアニン誘導体等、公知のものから任意に 30選択して用いることができる。なお、これらの核剤は一種のみを単独で、または、二種以上を組み合わせて用いることができる。

# ④ 可塑剤

可塑剤としてはポリエチレングリコール、ポリアミドオリゴマー、エチレンピスステアロアマイド、フタル酸エステル、ポリスチレンオリゴマー、ポリエチレンワックス、シリコーンオイル等公知のものから任意に選択して用いることができる。なお、これらの可塑剤は一種のみを単独で、または、二種以上を組み合わせて用いること 40ができる。

#### 【0026】⑤ 離型剤

離型剤としてはポリエチレンワックス、シリコーンオイル、長鎖カルボン酸、長鎖カルボン酸金属塩等公知のものから任意に選択して用いることができる。なお、これらの離型剤は一種のみを単独で、または、二種以上を組み合わせて用いることができる。

#### 【0027】⑥ プロセスオイル

本発明においては、伸度の向上のために、さらに40℃での動粘度が $15\sim600$ mm $^2/s$ であるプロセスオ

イルを配合することが好ましい。

【0028】プロセスオイルは油種により、パラフィン系オイル、ナフテン系オイル、アロマ系オイルに大別されるが、この中でもn-d-M法で算出されるパラフィン(直鎖)に関わる炭素数の全炭素数に対する百分率が60%Cp以上のパラフィン系オイルが好ましい。

10

【0029】プロセスオイルの粘度としては、40℃での動粘度が $15\sim600\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{s}$  が好ましく、 $15\sim500\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{s}$  が更に好ましい。プロセスオイルの動粘度が $15\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{s}$  未満では伸度向上効果があるものの、沸点が低くSPSとの溶融混練、及び成形時に白煙、ガス焼け、ロール付着等の発生原因になる。また動粘度が $600\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{s}$  を超えると、白煙ガス焼け等は抑制されるものの、伸度向上効果に乏しい。なおこれらのプロセスオイルは一種のみを単独で、又は二種以上を組み合わせて用いることができる。

【0030】上記の各種添加量は、SPS, SPS以外の熱可塑性樹脂、熱可塑性エラストマー及び相溶化剤の合計 100質量部に対して、必要に応じて好ましくは $0\sim1$ . 5質量部の範囲で配合すればよい。本発明の離型フィルムは、少なくとも1つの表面層が上記のような組成や物性を有するが、そのフィルムの厚みとしては、 $25\sim300\mu$ mであればよく、好ましくは $40\sim200\mu$ m、特に好ましくは $75\sim150\mu$ mである。厚みが $25\mu$ m未満では所望の離型性を得るのが困難であるからである。また、このフィルムの厚みが $300\mu$ mを超えても特に性能のさらなる向上が認められず、経済性に不利である。

【0031】また、本発明の離型フィルムは、1層又は2層以上の層からなる。即ち本発明の離型フィルムの層構成は、少なくとも1つの表面層が上記の条件を満たす限り、1層でもよく、2層、又は3層以上であってもよい。これらの中でも、本発明においては、その層構成を3層以上にしたものが、離型性と力学物性をともに著しく高めることができる点で好ましい。

【0032】次いで、本発明の離型フィルムの層構成が 3層以上の場合の好ましい態様の1つについて説明す る。

2. 離型フィルムの層構成が3層以上の場合の好ましい 能

・

それは、それぞれ後述するA層、B層及びC層で構成され、A層及びC層を表面層とし、両表面層の間に1又は 2層以上のB層が存在する総厚みが $25\sim300~\mu$ mの離型フィルムである。

【0033】以下、A層、各B層、及びC層の内容(組成、物性)について説明する。

#### A層

本発明に用いるA層としては、上記の「少なくとも1つ の表面層」で挙げたと同様の組成及び物性を有する層を 50 用いることができる。すなわち、SPSを主成分とし含

有し、しかも該表面層の光沢度が100%未満である層である。また、より好ましくは、その組成がSPS85~99.9質量%、SPS以外の熱可塑性樹脂及び熱可塑性エラストマーから選ばれた1種又は2種以上を0.1~15質量%、並びに相溶化剤0~10質量%を含む層であって、しかも該層の光沢度が100%未満である層であり、特に好ましくは、SPSを85~99.9質量%含有するとともに、SPS以外の熱可塑性樹脂及び熱可塑性エラストマーから選ばれた1種又は2種以上を0.1~15質量%、並びに相溶化剤0~10質量%含むものである。また、A層には、前記各種添加量を、SPS、SPS以外の熱可塑性樹脂、熱可塑性エラストマー及び相溶化剤の合計100質量部に対して、必要に応じて好ましくは0~1.5質量部の範囲で配合してもよい。

#### 【0034】各B層

本発明に用いるのB層としては、スチレン系重合体30 ~90質量%、好ましくは35~80質量%、特に好ま しくは40~70質量%,並びにスチレン系重合体以外 の熱可塑性樹脂及び熱可塑性エラストマーから選ばれた 20 1種又は2種以上を10~70質量%, 好ましくは20 ~65質量%、特に好ましくは30~60質量%、並び に相溶化剤0~30質量%を含有する層である。スチレ ン系重合体30質量%未満、及び90質量%を超える と、いずれも積層フィルムの力学物性が不充分であっ て、本発明の目的を達成できない。このB層は、1層で あってもよく、2層以上であってもよい。B層が2層以 上存在する場合は、各層の組成は同一であってもよく、 上記の範囲で異なっていてもよい。また、本発明におい ては、B層の少なくとも1層が、SPS30~70質量 30 %、SPS以外のスチレン系重合体0~30質量%、ポ リオレフィン系樹脂10~50質量%、熱可塑性エラス トマー0~30質量%、好ましくは5~30質量%、及 び相溶化剤B層0~30質量%を含有することが望まし い。このように、スチレン系重合体としてSPSを用 い、SPS以外の熱可塑性樹脂としてポリエチレンやポ リプロピレンなどのポリオレフィン系樹脂を用いるのが 好ましく、特にさらに熱可塑性エラストマーをも併用す る場合が好ましい。また、B層には、A層と同様に相溶 化剤を配合してもよいが、その配合割合は、A層の場合 40 より多くてもよく30質量%以下の範囲で配合してもよ い。B層は、A層の場合よりSPS以外の熱可塑性樹脂 などの割合が高いからである。なお、B層も、A層の場 合と同様に、前記各種添加量を、スチレン系重合体、ス チレン系重合体以外の熱可塑性樹脂、熱可塑性エラスト マー、及び相溶化剤の合計100質量部に対して、必要 に応じて好ましくは0~1.5質量部の範囲で配合して もよい。以下、スチレン系重合体、スチレン系重合体以 外の熱可塑性樹脂、熱可塑性エラストマー、相溶化剤及 び各種添加剤について説明する。

12

【0035】(2-1)スチレン系重合体

本発明のB層に用いるスチレン系重合体は、前記(1-1)で挙げたSPSのみならず、アタクチックポリスチレン、アイソタクチックポリスチレン、GPPS, HIPSなどシシンジオタクチック構造を有しないスチレン系重合体も含まれる。これらのスチレン系重合体も、積層フィルムの力学物性を向上させ、耐熱性を維持できるため、B層の構成要素として使用できる。これらスチレン系重合体の中でも、耐熱性がより優れる点でSPSが特に好ましい。

【0036】(2-2)スチレン系重合体以外の熱可塑 性樹脂

本発明のB層に用いるスチレン系重合体以外の熱可塑性 樹脂等についても(1-2)SPS以外の熱可塑性樹脂 で挙げたものと同様なものを使用できる。但し、スチレ ン系重合体以外の熱可塑性樹脂には、(1-2)で挙げ られた、アタクチックポリスチレン、アイソタクチック ポリスチレン、HIPSは除かれる。

【0037】また、(2-3) 熱可塑性エラストマー、(2-4) 相溶化剤及び (2-5) 各種添加剤については、 $(1-3) \sim (1-5)$  で挙げたものと同様のものを使用できる。

#### 【0038】<u>C層</u>

本発明のC層としては、SPSを70~100質量%、 好ましくは80~100質量%、SPS以外の熱可塑性 樹脂及び熱可塑性エラストマーから選ばれた1種又は2 種以上を0~30質量%、好ましくは0~10質量%、 特に好ましくは0~5質量%,並びに相溶化剤0~10 質量%,好ましくは0~5質量%を含有する層を用いる ことができる。SPSの割合が70質量%未満である と、離型フィルムの耐熱性が低下し、また同時に離型性 も不充分になるため離型フィルムとしては好ましくな い。

【0039】特に、C層についてもA層と同様に、表面層の光沢度が100%未満であるのがのが好ましく、さらにA層と同様に、SPSの割合が85~99.9質量%であることが好ましい。また、特に好ましい態様についてもA層で挙げた組成と同じ物を挙げることができる。

【0040】本発明の本発明の離型フィルムは、A層、1又は2層以上のB層及びC層であるが、製造工程を簡素化する上で、A、B、C層が各1層である3層の離型フィルムが特に好ましい。この離型フィルムの各層の厚みについては、A層とC層については $5\mu$  m以上が好ましく、 $10\mu$  m以上がより好ましい。また、B 層については、 $30\mu$  m以上がより好ましく、 $50\mu$  m以上が特に好ましい。また、各層の層の厚さの比、A層:全B層:C層は、 $1\sim49$ : $50\sim98:1\sim49$ が好ましく、さらには $5\sim30:40\sim90:5\sim30$ 、特に $10\sim20:60\sim80:10\sim20$ が好ましい。この

ように中間のB層の割合を高くすることによって、B層に特に必要な機能や所望の他の機能を付加するための配合剤を加えることができ、離型フィルムの機能を向上できる。また、離型フィルム全体の厚みとしては、前記と同様  $25\sim300\mu$  mが好ましく、さらには  $40\sim200\mu$  m、特に  $75\sim150\mu$  mが好ましい。

#### 【0041】3. 離型フィルムの結晶化度

本発明に用いるフィルム中、特に、少なくとも1つの表面層中のSPSの結晶化度については、30%以上であることが好ましく、さらに好ましくは45%以上、特に 10好ましくは50%以上である。結晶化度が30%未満のSPSでは、離型性が低下することがあるからである。

#### 【0042】4. 積層体フィルムの製造方法

本発明にかかる離型フィルムの製造方法は特に問わず、例えば、キャスト成形、インフレーション成形、二軸延伸成形等を用いることができる。さらには、これらの成形を行った後に、目的の結晶化度を得るために熱処理等を施してもよい。中でもフィルムの厚みの均一性を高め、生産性を重視する観点から、キャスト成形(3種3層フィルム用成型装置による共押し出し成形)によるの20が好ましい。

## 【0043】5. 積層体フィルムの用途

本発明の離型フィルムは、離型性及び力学物性に優れる ため、剥離フィルム、工程フィルム、包装フィルム等の 離型フィルムとして利用することができる。即ち、剥離 フィルムとしては、具体的には、例えば、粘着テープ、 両面テープ、マスキングテープ、ラベル、シール、ステ ッカー等において用いられているものであり、或いは不 織布等で作られた皮膚貼付用湿布剤の薬面に貼られてい るフィルムである。また工程フィルムとは、前述のよう に、プリント基板やICチップ(ウエハーモールド)、 セラミックス電子部品、熱硬化性樹脂製品、化粧板等を 製造する時、金属板同士や樹脂同士が接着してしまわな いように、成形工程時に該金属板同士の間や樹脂同士の 間に挟み込まれるフィルムをいい、特に積層板製造時、 フレキシブルプリント基板製造時、先端複合材料製品製 造時、スポーツ・レジャー用品製造時に好適に用いられ るものである。積層板製造時に用いられる離型フィルム とは、具体的には、例えば、多層プリント基板を製造す る際のプレス成形において、プリント基板とセパレータ 40 ープレート又は他のプリント基板との間の接着を防止す るために間に存在させるフィルムをいう。また、フレキ シブルプリント基板製造時に用いられる離型フィルムと\*

14

\*は、具体的には、例えば、電気製品における可動部分に 組み込まれている変形可能なフレキシブルプリント基板 の製造時、ベースフィルム上にエッチング等により形成 された電気回路を保護するためのカバー樹脂を加熱プレ スする際、このカバー樹脂を回路の凹凸部に密着させる ためにカバー樹脂を包むように用いられるフィルムをい う。先端複合材料製品製造時に用いられる離型フィルム とは、例えば、ガラスクロス、炭素繊維又はアラミド繊 維とエポキシ樹脂からなるプリプレグを硬化させて種々 の製品を製造する際に用いられるフィルムをいう。スポ ーツ・レジャー用品製造時に用いられる離型フィルムと は、例えば、釣り竿、ゴルフクラブ・シャフト、ウィン ドサーフィンポール等の製造において、ガラスクロス、 炭素繊維、又はアラミド繊維とエポキシ樹脂からなるプ リプレグを円筒状に巻き、その上にフィルム製のテープ を巻き付けてオートクレーブ中で硬化させる際に用いら れるフィルムである。

## [0044]

【実施例】次に、本発明を実施例によりさらに具体的に 説明するが、本発明はこれらの例により何ら限定される ものではない。

#### [物性評価方法]

#### (1) 光沢度

スガ試験機(株)社製 デジタル変角光沢計を用い、JISK7105に準拠して測定した。測定角度60°で測定し、屈折率1.567のガラス表面の光沢度を100%として各フィルムの光沢度を表示した。

#### (2)結晶化度

フィルムを示差走査熱量計にて20  $\mathbb{C}/$ 分の速度で昇温することにより測定して得た融解エンタルピー( $\Delta H$  f)及び冷結晶化のエンタルピー( $\Delta H_{TCC}$ )の値より、次式にて算出した。

[0045] 結晶化度(%) = 100×( $\Delta$ Hf- $\Delta$ H Tcc)/53(J/g)

#### (3) 引張り伸び

JIS K 7127に準拠して測定した。具体的には、1号試験片を用い、試験速度200mm/minで行った。

#### (4) 離型性

図1に示すような構成下、180℃,4MPaの圧力で150分間プレスし、室温にて放冷し、酸化銅張板とのピール強度及びフィルム外観を測定した。

〔用いた原料〕

・SPS : シンジオタクチックポリスチレン

出光石油化学社製 ザレック

Tm = 2.70%, MI = 3 (3.00%, 1.2 kg f)

・LDPE : 低密度ポリエチレン

日本ユニカー社製 NUC-8042

・PP : ポリプロピレン 50

16

出光石油化学社製 IDEMITU PP E-185G

・SEBS : SEBSタイプエラストマー

クラレ社製 Septon 8006

・相溶化剤 : SEBS

クラレ社製 Septon 8104

【0046】〔実施例1〕A層として、SPS95質量%及びPP5質量%、B層としてSPS55質量%、PP15質量%、SEBS15質量%及び相溶化剤15質量%、C層として、A層と同様、SPS95質量%及びPP5質量%からなるそれぞれの組成物を準備した。次いで、それぞれの組成物100質量部に対し、酸化防止剤として、「Irganox1010」(チバガイギー社製)、「PEP36」(旭デンカ社製)、及び「スミライザーGS」(住友化学工業社製)をそれぞれ0.1質量部を配合した。これらをそれぞれをドライブレンドし、65mmφ二軸押出機にて溶融混練して各ペレットを得た。これを50mmφ単軸(フルフライトタイ

プスクリュー)押出機に500mm幅のコートハンガーダイを取り付け、押出量20kg/hrにて300℃で共押出成形し、A層、B層及びC層が各々 $15\mu$ m、 $70\mu$ m、 $15\mu$ mで総厚みが $100\mu$ mのフィルムを得た。このフィルムをテンターを用い、200℃にて30秒間連続して熱処理して実施例1000離型フィルムを得た。このフィルムについて、光沢度、結晶化度、引張り伸び、及び離型性を評価した。得られた結果を表1に示す。

【0047】 【表1】

		_								(1	0)											
A開展製化網絡版	との種類性 (1807C、	40kg/am,150min)	Ž		ı	1	HH	H.	H	BH	917	27.0	2	22	H	AH	HRBU	を担任事	4111	五年17年	118.00	ご美術を
AWA	との権団	40kg/ar	Be an		T T	<b>X</b>	0.1	0.1	0.1%	0.1未指	0.1未滞	##10	4.4	X +	X	0.1%	3.8	15.7	۽	\$ 1	27	<del>-</del>
2年間に			2	F		ים	-	Т	œ	8	7	•	•		-	2	9	17		1	=	2
<u></u>				] §	ŀ	٠	= 0	اھ	~	-	7	7.	•	·	•	2	12	25	٩	•	ŝ	•
SPS	Man to R			Ξ		5		3	2	S	52	53	2	5	3 1	32	21	48	72	5 5	8	63
	**************************************				ä	3	8 8	70	2	22	62	75	A.	3 4	3	=	힐	3	5	3 5	₹ ,	2
10000000000000000000000000000000000000	AM / BM / Ch				18/70/15	15/10/13	51/0//51	61 /0/ /61	13/83	15/85	15/85	100	15/70/15	15/70/15			15/70/15	15/70/15	15/70/15	15/70/15	61 /0/ /61	30/100
74.6厘34				["]	٤	3 5	3 5	3 8	3 5	8	100	901	20	٤	٤	3	В	<u>8</u>	20	,	3	130
			SEBS 無路化粧	(X)	٥	,	,			1	1	ŀ	٥	-		!	2	15	0	-		
	İ		SEBS			-	٦	<b>)</b>			I	I	٥	0	1	1	5	٥	0	-		
	1	3	맖	3	15		-	·			I	1	5	2		•	-	33	10	-	·	
			COPE		<u> </u>	-	٥	·			1		0	0	1	5	2	0	0	-		
		$\downarrow$	SPS	[MUR]	58	à	6				1	1	95	88		ş	8	8	92	8		
			SEBS ##RL#	Z.	22	=	2	=	2 4	2	2	i	5	15		=	2	15	15	15	,	プレイアンノナノ
展			SEBS	[west	15	2	2	=	2	2	2	1	15	15	I	=	3	2	15	15		
村料組成		1	8	[MX]	15	55	22	45	=	2	2		15	15	!	٥	}	0	15	0		
•			LOPE	[m(8]	0	0	0	6	c	ŀ	9	!	0	0	!	=		12	0	12		l
			SPS	(K)	55	55	52	23	Ę	:	2		22	55	1	15		S	æ	55		
			SEBS 抽消化剂	(m)	0	0	•	0	0	-	•	5	0	0	0	2	: :	2	٥	*	•	
			SEBS	[44]	0	4	0	0	-	[	•	2	٥	0	0	٥		9	0	4	1	
	¥	Ľ	<u>R</u>	Ī	2	4	•	5	4		-	0	2	5	0	۰		ន	2	0	0	
				<b>S</b>	0	0	0	0	0	٠		5	9	0	0	2			0	12	12	
			SPS	3	95	92	92	95	92	60		82	8	8	5	90	۶	3	82	8	8	
	_	_			夹飾例1	更施例2	夹施例3	実施例4	東施例5	the Colle	K E	大配別/	吳簡例8	東衛衛9	比較例1	比較例2	11 85 6512	2	L. K. F. de	比較例5	比較例	

【0048】 〔実施例2~9、比較例1~5〕表1に示 すA層、B層及びC層の各組成の材料を用い、表1に示 す各層のフィルム厚みとフィルムの総厚みになるように した以外は、実施例1と同様にして各離型フィルムを作 製した。但し、これらの各層に、実施例1と同様に表1 50

中の組成物100質量部に対し、実施例1と同様の酸化 防止剤を各0.1質量部配合した。これらのフィルムに ついて、光沢度、結晶化度、引張り伸び、及び離型性を 評価した。得られた結果を表1に示す。

〔比較例6〕表1のA層欄に示す組成物とポリ(4-メ

チルペンテン-1) (三井化学製、「MX0002」) を共押出してフィルムを作製した以外は実施例1と同様 に行った。但し、A層欄に示す組成物には、実施例1と 同様な酸化防止剤を各0.11質量部配合した。結果を 表1に示す。

【発明の効果】本発明の離型フィルムは、耐熱性、環境 [0049] 適性、作業性に優れたとともに、離型性及び引張伸びな どの力学物性が共に優れる。したがって、プリント基板

製造などに用いられる離型フィルムとして有効である。

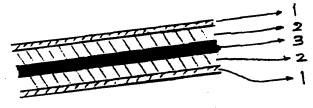
【図1】離型性試験のために、ステンレス板、試験フィ 【図面の簡単な説明】 ルム、酸化銅張樹脂板を重ねた模式図である。

ステンレス板 (表面粗さ:1μm以下、バフ研 【符号の説明】 磨)

試験フィルム

酸化銅張樹脂板

[図1]



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7 9:06) C08L

識別記号

FI9:06) C08L

テーマコード(参考)

Fターム(参考) 4F100 AK01A AK01B AK01C AK01D AKO1E AKO3A AKO3B AKO7 AK11A AK12A AK12B AK12C AK12D AK12E AK73 AL05A ALOSB ALOSC ALOSD ALOSE ALO9A ALO9B ALO9C ALO9D AL09E AN02A AN02B BA02 BAO3 BAO4 BAO5 BAO6 BAO7 BA10A BA10B CA30 EH20 EH202 GB43 JA11A JA11B JA11C JA11D JA11E JB16A 1B16B 1B16C 1B16D 1B16E JJ03 JL14 JN21A JN21B YYOOA YYOOB

41002 AC012 AC032 AC062 AC083 AC092 BB152 BC011 BC031 BC051 BC071 BC111 BG042 BN152 BN162 BN172 BP012 BP013 CH042 CK022 CN022 CP032 FD070 FD160 GF00

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.